

技術・サービス

- ▷自動車部品の樹脂製品において、3次元形状が求められる設計開発を行っております。
- ▷自動車部品の電装品(メータ、ランプ等)において、電子制御を行っております。
- ▷自動車とインターネットを使ったサービス展開をメーカーと共同で開発しております。
- ▷機械設計分野(外装設計や光学検討)、電子基板分野(回路設計、基板設計、組込み開発)、アプリ開発(PCソフトやスマートフォン・タブレットアプリ)を一括開発を行っております。
- ▷無線(Bluetooth、Wifi)を使ったシステムや携帯回線(LTE等)を使って、クラウドへ情報を送受信するシステム開発を行っております。
- ▷センサ情報を分析して、故障管理等のシステム開発を行っております。



脳活動計測とDRIVEレコーダー連動のソリューション
NeU-DRIVE
 Solutions for brain activity measurement and DRIVE recorder interlocking



クラウドアドバイザー with HealthData
 Cloud Advisor with HealthData

電気・電子機器

強み

- ▷設計開発がトータル的に行える会社となります。システム開発において必要である機械設計分野、電子基板分野、ソフトウェア分野の全てを自社内で行っている事により、各部門間の調整も行いやすいので、開発の待ちが出ないような流れで業務を行える事が強みとなります。また、製作においても協力会社との連携が出来ておりますので、設計から製作まで開発案件において一式で行える事が強みとなります。

メリット

- ▷製品開発において、仕様を決める事に関しては、時間がかかる作業ではありますが、簡単なイメージが取引先様にあれば、それを基に取引先様とのやり取りの中で仕様を決めていく事が出来る為、全体のスケジュールが立てやすい事がメリットとなります。また、一括で開発出来る為、各部門毎に取引先様が開発会社を管理するよりも一社管理する事で、ご担当者様の負担が減ります。

企業名	株式会社KYOWAエンジニアリング・ラボラトリー			電話	054-265-1783
所在地	静岡市駿河区国吉田6-5-14			FAX	054-265-1928
代表者名	代表取締役社長 太田 恭平	設立年月	1992年2月	URL	https://www.kywo.co.jp
資本金	50,000千円	従業員数	89名	問合せ担当	和田 芳明
事業内容	システム設計・開発、外装設計、回路・基板設計、組込み開発、アプリ開発				
拠点(国内・海外)	本社(静岡市駿河区)、島田事業所(島田市)、豊田事業所(愛知県豊田市)				
主要取引先	矢崎総業(株)、(株)小糸製作所、(株)村上開明堂				
認証・規格	ISO9001:2015、ISO/IEC27001:2013				